

ОСОБЕННОСТИ ОТЖИГА КОМПЛЕКСОВ B_iO_i В *p-Si* ПРИ ИНЖЕКЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

С. Б. Ластовский, Л. И. Мурин, В. А. Гуринович, В И. Кульгачев

Научно-практический центр НАН Беларусь по материаловедению
E-mail: lastov@ifsttp.bas-net.by

ВВЕДЕНИЕ

Примесные атомы бора играют важную роль в процессах радиационного дефектообразования в *p-Si* и являются одними из основных стоков для собственных междоузельных атомов кремния, которые в условиях электронного облучения обладают чрезвычайно высокой подвижностью даже при очень низких температурах [1]. В свою очередь, междоузельные атомы бора (B_i) также обладают высокой подвижностью и могут взаимодействовать с другими примесями [2, 3]. В промышленных кристаллах и пленках *Si* такой примесью являются междоузельные атомы кислорода O_i . Комплексы B_iO_i , являются электрически активными центрами с донорным уровнем у $E_C - 0,25$ эВ [4-6] и могут оказывать существенное влияние на свойства кристаллов *Si* и, соответственно, на параметры приборных структур. В то же время в литературе практически отсутствует информация о механизме отжига комплексов B_iO_i . В связи с вышеизложенным нами были проведены методом *DLTS* исследования влияния инжекционно-термических обработок на поведение радиационных дефектов (РД) в *p*-базе кремниевых диодов, облученных быстрыми электронами.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В качестве экспериментальных образцов использовались диодные $n^+ - p$ -структуры, изготовленные на пластинках кремния КДБ-4,5. *P-n*-переход формировался диффузией фосфора в *p*-базу. Глубина залегания *p-n*-перехода составляла 2÷3 мкм, площадь $2,7 \times 2,3$ мм². Образцы облучались электронами ($E = 6$ МэВ) при температуре 273 К и плотности потока электронов 10^{12} см⁻²с⁻¹.

Изохронный (30 минут) отжиг облученных образцов в области температур 273÷398 К проводился с шагом 25 К в криостате *DLTS* спектрометра, а при более высоких температурах — в печи на воздухе. Отжиг в криостате позволял подавать на образец дополнительное прямое смещение.

Определение электронных характеристик РД в базовой области *p-n*-структур осуществлялось методом *DLTS*. Спектры измерялись в режимах заполнения ловушек как основными, так и неосновными носителями заряда.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены *DLTS*-спектры диодной $n^+ - p$ -структуры, облученной электронами. В результате облучения в базовую *p*-область вводятся РД, перезарядка которых приводит к возникновению на спектрах максимумов при температурах 124, 157, 195 К и минимума при 133 К.

Ловушкам с пиками при 124, 157 и 195 К соответствуют глубокие уровни у $E_v + 0,18$ эВ, $E_v + 0,29$ эВ и $E_v + 0,36$ эВ. Ловушке с минимумом при 133 К соответствует уровень донорного типа у $E_c - 0,24$ эВ. В целом вид *DLTS* спектра типичен для облуч-

ченного электронами p -Si, полученного методом Чохральского [3-8]. Уровень с максимумом при 124 К принадлежит дивакансии $V_2(+/0)$, при 157 К — углероду внедрения $C_i(+/0)$, при 195 К — «предвестнику» комплекса углерод внедрения — кислород внедрения $C_iO_i^*(+/0)$ [7] и уровень с минимумом при 133 К — комплексу бор внедрения — кислород внедрения $B_iO_i(0/+)$.

Амплитуды пиков, соответствующих вышеуказанным РД, на DLTS спектрах облученных электронами диодных n^+ - p -структур существенно изменяются в процессе изохронного отжига. Самой низкой термической стабильностью обладает ловушка C_i . Соответствующий пик (157 К) исчезает после $T_{отж} = 320$ К (рис. 2). Подвижные C_i захватываются атомами кислорода с образованием термически стабильного до 670 К комплекса C_iO_i . При этом «предвестник» комплекса $C_iO_i^*$ трансформируется в комплекс C_iO_i , что выражается в смещении на несколько градусов максимума пика C_iO_i в область более высоких температур [7].

При $T_{отж} = 350$ К наблюдается некоторое уменьшение амплитуды пика ловушки, обычно приписываемой V_2 . Это связано с изменением конфигурации тривакансии V_3 . Один из глубоких уровней данного центра ($E(0/+) = E_v + 0,19$ эВ) по своему значению близок к уровню $V_2(+/0)$ и на спектрах пики этих уровней совпадают по температуре [8]. Сразу после облучения из-за сильного возбуждения электронной подсистемы кристалла центр V_3 имеет планарную структуру и DLTS-пик при 124 К представляет собой сумму пиков ловушек $V_2(+/0)$ и $V_3(+/0)$. При $T_{отж} = 350$ К V_3 переходит в конфигурацию FFC и уровень $V_3(+/0)$ не наблюдается на спектрах [8].

На рис. 3 представлены изменения амплитуд DLTS-пиков РД в процессе изохронного отжига диодной n^+ - p -структуры, через которую при отжигах пропускался прямой ток $I_{пр} = 300$ мА. Данная n^+ - p -структура облучена такой же дозой электронов и при тех же условиях, что и n^+ - p -структура, отожженная в режиме без инжекции неосновных носителей заряда (ННЗ) (см. рис. 2).

Дополнительная инжекция ННЗ существенно влияет на характер отжига ловушек C_i , $C_iO_i^*$ и B_iO_i . Главным образом это выражается в том, что указанные центры начинают отжигаться при более низких температурах. Так, пропускание прямого тока через образец в течение 30 минут при 273 К ведет к полному отжигу ловушек C_i и $C_iO_i^*$. При этом резко возрастает амплитуда пика C_iO_i .

Для комплекса B_iO_i инжекция ННЗ приводит к уменьшению температуры отжига на 75-100 К, что видно из сравнения данных, приведенных на рисунках 2 и 3. При этом наблюдается резкое (35 %) уменьшение амплитуды пика данной ловушки уже при $T_{отж} = 273$ К.

В результате проведенных исследований установлено, что инжекция в базовую p -область неосновных носителей заряда в процессе изохронного (30 мин.) отжига кремниевых диодных n^+ - p -структур, облученных электронами с $E = 6$ МэВ, снижает на 50-100 К термическую стабильность таких радиационных ловушек, как углерод внедрения C_i , «предвестник» комплекса углерод внедрения — кислород внедрения $C_iO_i^*$ и бор внедрения — кислород внедрения B_iO_i .

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (проект Ф11-086).

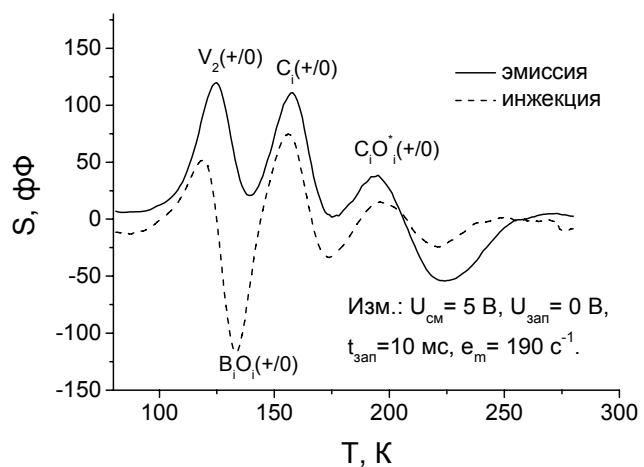


Рис. 1. DLTS-спектры облученной электронами при $T = 273 \text{ К}$ дозой $\Phi = 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ диодной n^+ - p -структуры, измеренные при перезарядке ловушек основными (сплошная линия) и неосновными (штриховая линия) носителями заряда

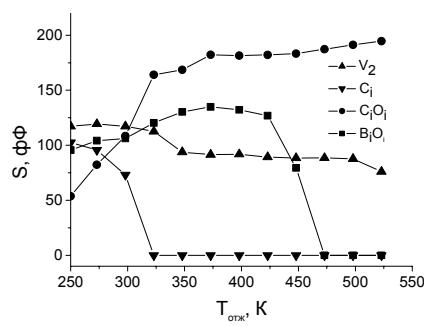


Рис. 2. Изменение амплитуд DLTS-пиков ловушек в процессе изохронного (30 мин.) отжига диодной n^+ - p -структуры, облученной электронами дозой $\Phi = 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$

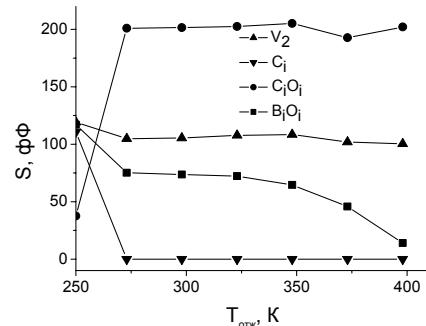


Рис. 3. Изменение амплитуд DLTS-пиков радиационных ловушек в процессе изохронного (30 мин.) отжига диодной n^+ - p -структуры под прямым смещением. $\Phi = 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вавилов, В.С.* Дефекты в кремнии и на его поверхности / В.С. Вавилов, В.Ф. Киселев, Б.Н. Мукашев. М.: Наука. 1990. 216 с.
2. *Watkins, G.D.* Defects in irradiated silicon: EPR and electron-nuclear double resonance of interstitial boron / G.D. Watkins // Phys. Rev. B. 1975. Vol. 12, № 12. P. 5824.
3. *Harris, R.D.* Negative-U defect—interstitial boron in silicon / R.D. Harris, J L. Newton, G.D. Watkins // Phys. Rev. B. 1987. Vol. 36, № 2. P. 1094.
4. *Mooney, P.M.* Defect energy levels in boron-doped silicon irradiated with 1-MeV electrons / P.M. Mooney [et al.] // Phys. Rev. B. 1977. Vol. 15, № 8. P. 3836.
5. *Kimerling, L.C.* Interstitial defect reactions in silicon / L.C. Kimerling [et al.] // Materials Science Forum. 1989. Vols. 38-41. P. 141.
6. *Khan, A.* Role of the impurities in production rates of radiation-induced defects in silicon materials and solar cells / A. Khan [et al.] // J. Appl. Phys. 2001. Vol. 90, № 3. P. 1170.
7. *Макаренко, Л.Ф.* Кинетика образования и отжига метастабильного состояния комплекса С_iO_i в кремнии р-типа / Л.Ф. Макаренко, Ф.П. Коршунов, С.Б. Ластовский, Л.И. Мурин // Доклады НАН Беларуси. 2007. Т. 51, № 5. С. 52.
8. *Markevich, V.P.* Structure and electronic properties of trivacancy and trivacancy-oxygen complexes in silicon / V.P. Markevich [et al.] // Phys. St. Sol. A. 2011. Vol. 208, № 3. P. 568.